

Conference Agenda

Tuesday, August 29, 2023			
MORNING	09:30-10:00	Room M2 Conference Opening Conference Director: Leo Lorenz, ECPE, DE	
	10:00 - 10:40	Room M2 Keynote: The New Generation of Gallium Nitride Power Devices; breaking the Limits of Ease-of-Use and Reliability Speaker: Florin Udrea, Cambridge GaN Devices, UK Chairperson: Leo Lorenz, ECPE, DE	
	10:40 - 10:50	Tea Break ☕	
	10:50 - 12:40	Room M2 IGBT and SiC Devices Chairperson: Gourab Majumdar, Mitsubishi Electric Corporation, JP	Room M3 Advanced Control and Associated Hardware Chairperson: Yongdong Li, Tsinghua University, CN
AFTERNOON	12:40 - 13:30	Lunch Break 🍽️	
	13:30 - 14:30	Poster Gallery Power Semiconductor Devices Chairperson: Meiqin Mao, Hefei University of Technology, CN	Poster Gallery Motion Control Chairperson: Zhihong Wu, Tongji University, CN
	14:30 - 16:20	Room M2 Si and WBG Devices Part I Chairperson: Ziyang Chen, Infineon Technologies, CN	Room M3 Converters Chairperson: Min Chen, Zhejiang University, CN
Wednesday, August 30, 2023			
MORNING	09:30-10:10	Room M2 Keynote: Packaging and Integration of Wide-Bandgap Power Semiconductors: Challenges and Opportunities Speaker: Christina DiMarino, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA Chairperson: Lie Xu, Tsinghua University, CN	
	10:10 - 10:20	Tea Break ☕	
	10:20 - 12:10	Room M2 Si and WBG Devices Part II Chairperson: Naoto Fujishima, Fuji Electric, JP	Room M3 Automotive Applications Chairperson: Xuhui Wen, Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, CN
AFTERNOON	12:10 - 13:30	Lunch Break 🍽️	
	13:30 - 14:30	Poster Gallery Power Semiconductor Modules Chairperson: Miao Zhu, Shanghai Jiao Tong University, CN	Poster Gallery Packaging Technologies Chairperson: Gaosheng Song, Great China Mitsubishi Electric Semiconductor, CN
	14:30 - 16:20	Room M2 Packaging and Reliability Chairperson: Norbert Pluschke, Semikron Danfoss, HKSAR, CN	Room M3 High Power and Grid Applications Chairperson: Dapeng Zheng, Shenzhen Hopewind Electric, CN
Thursday, August 31, 2023			
MORNING	09:30-10:10	Room M2 Keynote: Power Semiconductor Devices on Windpower Applications Speaker: Dapeng Zheng, Shenzhen Hopewind Electric, CN Chairperson: Jinjun Liu, Xi'an Jiaotong University, CN	
	10:10 - 10:20	Tea Break ☕	
	10:20 - 12:00	Room M2 Special Session: GaN based High Power Density Supplies Chairperson: Manfred Schlenk, Dr. Schlenk Consulting, DE	Room M3 Tutorial: High-Performance Power Modules and SiC Devices Speaker: Haihui Luo, Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd, CN Speaker: Sideng Hu, Zhejiang University, CN

研讨会日程

2023年8月29日，星期二

上午	09:30-10:00	M2 会议室 开幕致辞 研讨会主席: Leo Lorenz, 欧洲电力电子中心, 德国		
	10:00 - 10:40	M2 会议室 主题演讲: 新一代氮化镓功率器件; 突破易用性和可靠性的限制 演讲人: Florin Udrea, Cambridge GaN Devices, 英国 主持人: Leo Lorenz, 欧洲电力电子中心, 德国		
	10:40 - 10:50	茶歇 ☕		
	10:50 - 12:40	M2 会议室 IGBT和SiC器件 主持人: Gourab Majumdar, 三菱电机, 日本	M3 会议室 先进控制及相关硬件 主持人: 李永东, 清华大学, 中国	
下午	12:40 - 13:30 午餐 🍽️			
	13:30 - 14:30	墙报展示廊 功率半导体器件 主持人: 茆美琴, 合肥工业大学, 中国	墙报展示廊 运动控制 主持人: 吴志红, 同济大学, 中国	墙报展示廊 电源变换器 主持人: 张国强, 哈尔滨工业大学, 中国
	14:30 - 16:20	M2 会议室 Si和宽禁带器件I 主持人: 陈子颖, 英飞凌科技, 中国	M3 会议室 变换器 主持人: 陈敏, 浙江大学, 中国	

2023年8月30日，星期三

上午	09:30-10:10	M2 会议室 主题演讲: 宽禁带功率半导体的封装与集成: 挑战与机遇 演讲人: Christina DiMarino, 弗吉尼亚理工大学, 美国 主持人: 许烈, 清华大学, 中国		
	10:10 - 10:20	茶歇 ☕		
	10:20 - 12:10	M2 会议室 Si和宽禁带器件II 主持人: Naoto Fujishima, 富士电机, 日本	M3 会议室 汽车应用 主持人: 温旭辉, 中国科学院电工研究所, 中国	
下午	12:10 - 13:30 午餐 🍽️			
	13:30 - 14:30	墙报展示廊 功率半导体模块 主持人: 朱淼, 上海交通大学, 中国	墙报展示廊 封装技术 主持人: 宋高升, 三菱电机半导体大中国区, 中国	
	14:30 - 16:20	M2 会议室 封装和可靠性 主持人: Norbert Pluschke, 赛米控丹佛斯, 中国香港	M3 会议室 大功率和电网应用 主持人: 郑大鹏, 深圳禾望电气, 中国	

2023年8月31日，星期四

上午	09:30-10:10	M2 会议室 主题演讲: 功率半导体器件在风力发电中的应用 演讲人: 郑大鹏, 深圳禾望电气, 中国 主持人: 刘进军, 西安交通大学, 中国		
	10:10 - 10:20	茶歇 ☕		
	10:20 - 12:00	M2 会议室 特邀专题报告: 基于氮化镓器件的高功率密度电源 主持人: Manfred Schlenk, Dr. Schlenk Consulting, 德国	M3 会议室 技术讲座: 高性能功率模块与SiC器件 演讲人: 罗海辉, 株洲中车时代半导体, 中国 演讲人: 胡斯登, 浙江大学, 中国	